

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|
| spec ref | dr | Hai-Ling Liu | 2015/03/30 | projection | MM | size | A2 | scale | 1:1 | |
| tolerance std | eng | Hai-Ling Liu | 2015/05/11 | | | ecn no | - | rel level | Released | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 0.X ±0.5 0.XX ±0.25 0.XXX ±0.1 angular 0° ±2° | chr | Terris Liu | 2015/05/11 | | | | | | | |
| | appr | Pei-Ming Zheng | 2015/05/11 | | | | | | | |
| surface | | | | | product family | - | | rel level | Released | |
| | linear | | | | | title | HPCE BTB RAH | | rel level | Released |
| | angular | | | | | UNIVERSAL DRAWING | cat. no. | - | Product - Customer Drw | sheet 1 of 3 |

PDS: Rev :A

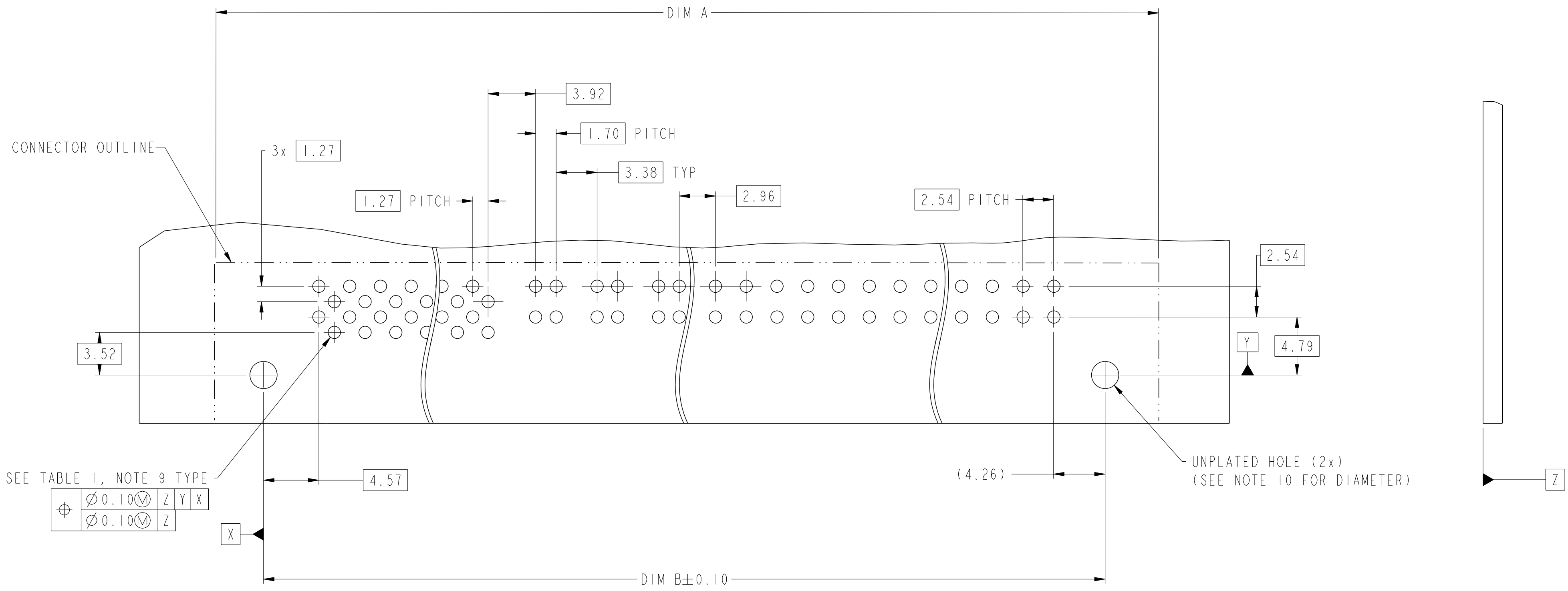
STATUS:Released

Printed: May 12, 2015



Copyright FCI.

| CONTACT TYPE | TOP LAYER DESCRIPTION | TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS | | | | |
|--------------|-----------------------|---|------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | | DRILLED HOLE DIAMETER | COPPER THICKNESS | TIN-LEAD THICKNESS | TIN THICKNESS | FINISHED HOLE DIAMETER |
| POWER | TIN-LEAD | 1.10-1.16 (1.15 DRILL) | 0.025 - 0.050 | 0.005 - 0.015 | -- | 0.94 - 1.10 |
| | IMMERSION TIN | 1.10-1.16 (1.15 DRILL) | 0.025 - 0.050 | -- | 0.9 - 1.5um | 0.94 - 1.10 |
| | COPPER (SEE NOTE 8) | 1.10-1.16 (1.15 DRILL) | 0.025 - 0.050 | -- | -- | 0.94 - 1.10 |
| SIGNAL | TIN-LEAD | 0.93-0.99 (0.98 DRILL) | 0.025 - 0.050 | 0.005 - 0.015 | -- | 0.77 - 0.93 |
| | IMMERSION TIN | 0.93-0.99 (0.98 DRILL) | 0.025 - 0.050 | -- | 0.9 - 1.5um | 0.77 - 0.93 |
| | COPPER (SEE NOTE 8) | 0.93-0.99 (0.98 DRILL) | 0.025 - 0.050 | -- | -- | 0.77 - 0.93 |



SEE TABLE 1, NOTE 9 TYPE

| | | | | |
|---|----------|---|---|---|
| ⊕ | ∅0.10(M) | Z | Y | X |
| ⊕ | ∅0.10(M) | Z | | |

TOP SURFACE
RECOMMENDED PCB LAYOUT

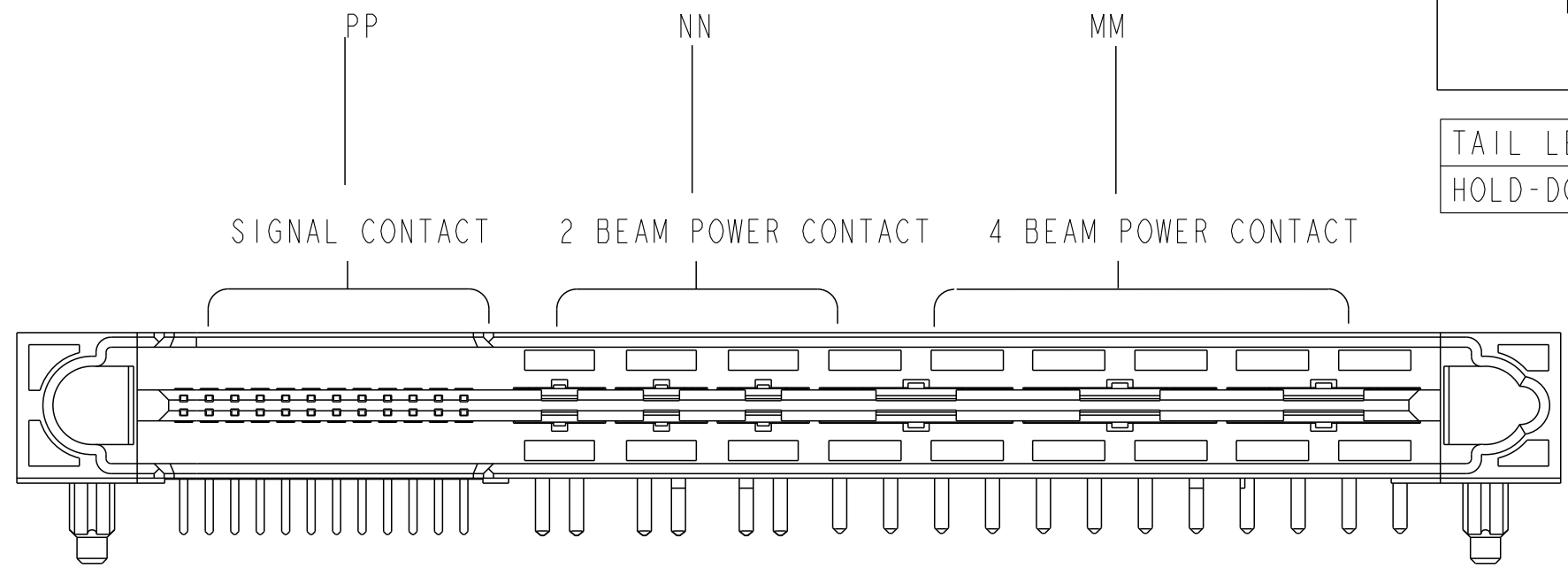
| | | | | | | | | |
|------|----------------|--|----------------|----|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| dr | Hai-Ling Liu | 2015/03/30 | projection | MM | size | A2 | scale | 1:1 |
| eng | Hai-Ling Liu | 2015/05/11 | | | ecn no | - | rel level | Released |
| chr | Terris Liu | 2015/05/11 | | | | | | |
| appr | Pei-Ming Zheng | 2015/05/11 | product family | - | cat. no. | - | Product - Customer Drw | sheet 2 of 3 |
| | | title HPCE BTB RAH UNIVERSAL DRAWING | | | dwg no 10134214 | rev A | | |

Copyright FCI.

10134214 - MM NN PP

LF
LEAD FREE

| | | | | |
|-----------------------|------|---|------|---|
| | A | B | C | D |
| TAIL LENGTH(DIM T) | 2.60 | | 3.25 | |
| HOLD-DOWN PEGS OPTION | Y | N | Y | N |



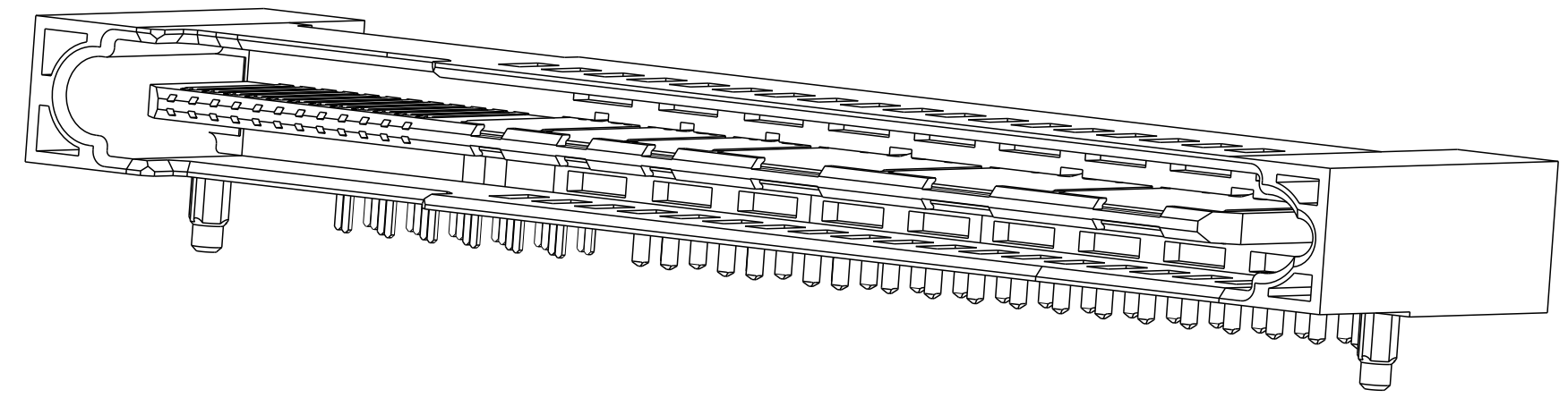
| | |
|----------|--|
| DIM | TABLE 2. LENGTH FORMULAS |
| DIM A II | $(MM + NN) / 2 \times 2.54 + (PP / 2) \times 1.27 + 16.02$ |
| DIM B | DIM A - 7.5 |
| DIM T | 2.60 OR 3.25 |

Example: The configuration above is 10134214-241224CLF
STD HPCE BTB R/A HEADER 36P24S with Hold-Down Pegs.
24P is 4 beam contact, 12P is 2 beam contact.

TABLE 3: PART NUMBER CODE. HPCE BTB R/A HEADER P+S CONFIG

NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
- CONTACT FINISH REF. GS-12-1031 SECTION TBD
- PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1125
- APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-0388
- PRODUCT MARKING (FCI PART NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
- PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-2272.
- HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
- ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
- MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
 $\varnothing 2.20 \pm 0.05$ FOR SOLDER TAILS
- MAXIMUM OVERALL LENGTH IS 100 mm



Copyright FCI. FCI

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------------|--|----|--------------------|----|------------------------|--------------|
| dr | Hai-Ling Liu | 2015/03/30 | projection | MM | size | A2 | scale | 1:1 |
| eng | Hai-Ling Liu | 2015/05/11 | | | ecn no | - | rel level | Released |
| chr | Terris Liu | 2015/05/11 | | | | | | |
| appr | Pei-Ming Zheng | 2015/05/11 | product family | - | cat. no. | - | Product - Customer Drw | sheet 3 of 3 |
| | | | title HPCE BTB RAH UNIVERSAL DRAWING | | dwg no 10134214 | | rev A | |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9